

E

D

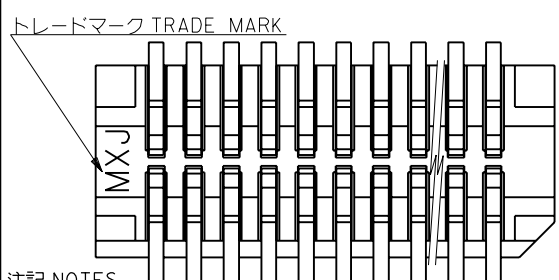
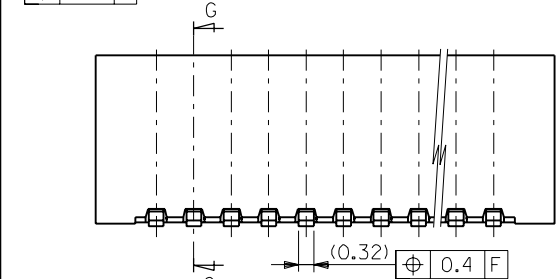
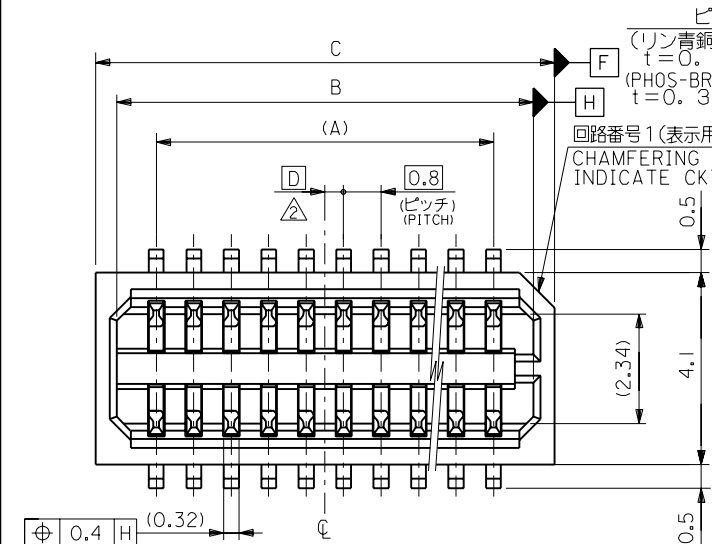
C

B

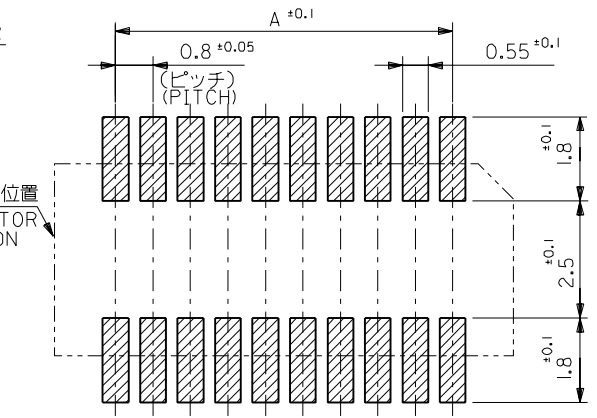
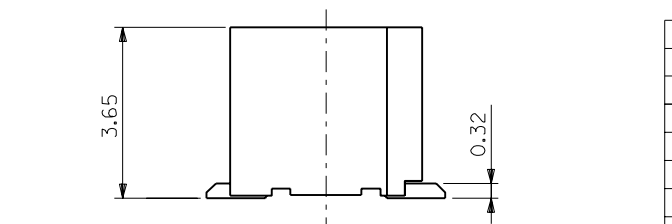
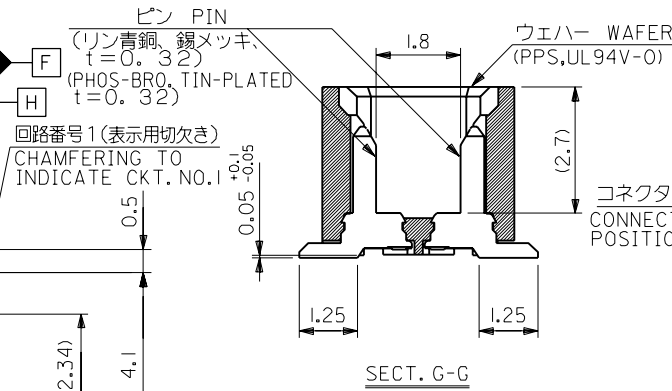
A

mm

mm



注記 NOTES
1. 嵌合相手: 52465,52588
MATE WITH: 52465,52588 SERIES
△ ウェハの ② から隣接するピンの ② 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ② OF WAFER TO ② OF ADJACENT PINS.



参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.) (MOUNT AREA)

0.4	17.8	16.9	15.2	53307-4027	40
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53307-1027	10

D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.
材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING					
仕上げ FINISH —					
適用電線範囲 WIRE RANGE —					
被覆外径 INS. RANGE —					
DRAWN BY '97/11/14 K.ASAKAWA CHK'D BY '97/4/1 Y.MIZUNO					
APP'D BY '97/4/1 M.FUKUSHIMA 尺度 —					
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					
TITLE 名称					
0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS)					
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV B					
SD-53307-**-27					

角度 ANGLE	±3°	B	変更 REVISION	97/4/1
30°以上 OVER	+0.3	A	変更 REVISION	95/8/9
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25	O	新規作成 PROPOSED	97/11/16
10°未満 UNDER	+0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. 日付 DATE

1

A



							材料 MATERIAL			 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社				
							SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				
							仕上げ FINISH	— # —		TITLE 名称				
							適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —		0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAfer ASS'y ST. SMT (WITHOUT BOSS)				
	B	変更 REVISED(JC70882)	T.A.	'97/4/1			被覆外径 INS. RANGE	— # —						
5	A	変更 REVISED(JC60094)	M.N.	'95/8/9			DRAWN BY '97/11/14 K.ASAKAWA	CHK'D BY '97/4/1 Y.MIZUNO			DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV B			
	O	新規作成 PROPOSED(J11001)	K.A.	'97/11/5			APP'D BY '97/4/1 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	— # —					
記号	LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE										

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MX-J-32

A53307.S10

DWG. NO.
SD-53307-***91

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

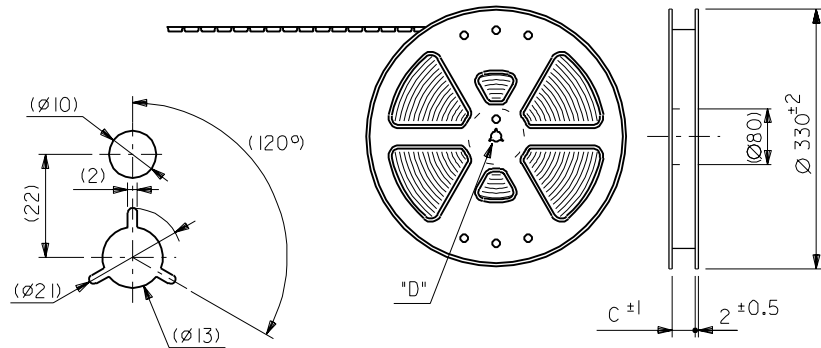
4

3

2

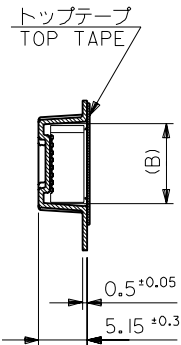
1

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION



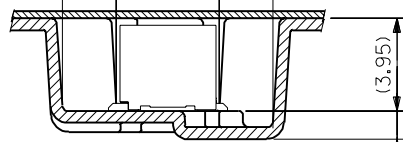
DETAIL "D"

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



SECT. Z-Z

(2.3) (4.4) (2.3)



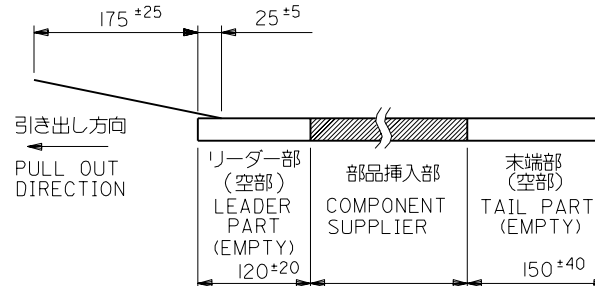
SECT. X-X
(SCALE:5-1)

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

注記 NOTES

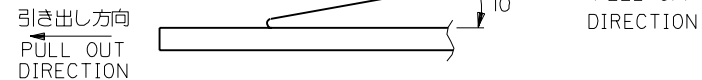
1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)
トップテープ: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS)
<リサイクル材を含む>

MATERIAL
CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
TOP TAPE: PET, PE, PEF
REEL: POLYSTYRENE (PS)
<RECYCLE MATERIAL
CONTAINED>

16	17.5	9.3	7.5	53307-1891	18
		8.5	6.7	53307-1691	16
		7.7	5.9	53307-1491	14
		6.9	5.1	53307-1291	12
		6.1	4.3	53307-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	30°以上 OVER 30	30°以下 UNDER 30	未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES
変更 REVISED	(JC2001-0479)	(JC70882)	(J11065)	記号 LTR
新規作成 PROPOSED	(J11065)			変更内容 REVISION RECORD
DR. CHK.	日付 DATE	尺度 SCALE		

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY 91/11/22 K.ASAKAWA	CHK'D BY 00/12/20 T.ITO
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV
SD-53307-***91	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

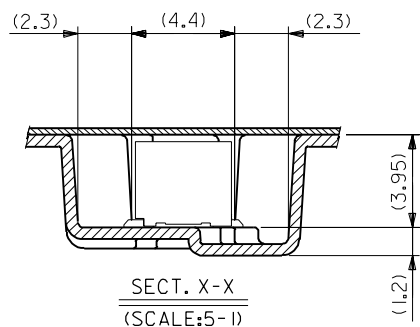
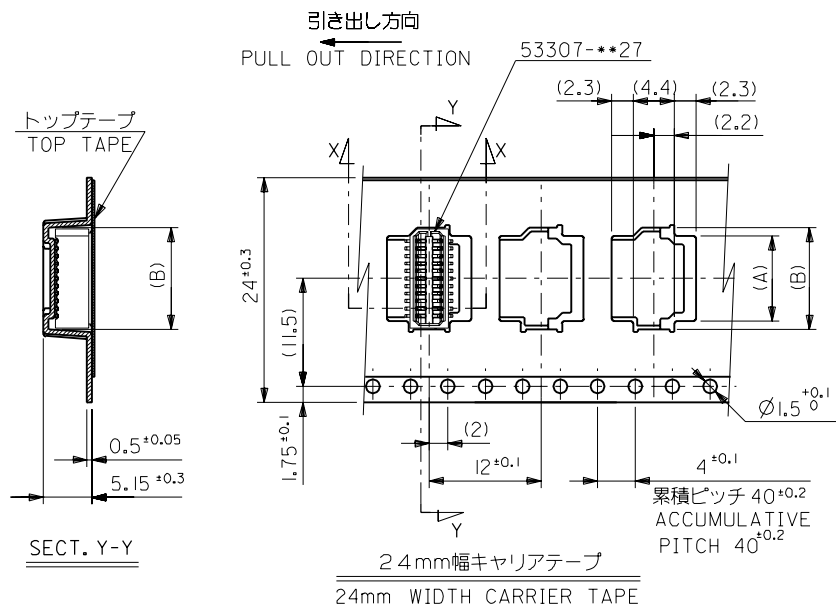
3

2

1

5949924A.S05

A ————— B ————— C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



角度	ANGLE
30 以上	OVER
10 以上	OVER
30 未満	UNDER
10 未満	UNDER
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

B	變 更	(JC2001-	T-X		
A	變 更	0479)	T-X		
O	REVISÉ	(JC70882	T-X		
	新規作成	(J11065)	K-A		
	PROPOSED				
記号	変更内容				DR.
TR	変更 RECORD				CHK

材料 MATRIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	
仕上り FINISH	—//—	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	
被覆外径 INS. RADIUS	—//—	
DRAWN BY 91/11/22 K. ASAKAWA	CHK'D BY 00/12/20 T. ITO	
APP'D BY 00/12/20 M. FUKUSHIMA	尺度 SCALE	—//—

 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV B

24	25.5	14.1	12.3	53307-3091	30
		13.3	11.5	53307-2891	28
		12.5	10.7	53307-2691	26
		11.7	9.9	53307-2491	24
		10.9	9.1	53307-2291	22
		10.1	8.3	53307-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

919927A 506	
-------------	--